

证券代码： 003031

证券简称：中瓷电子

河北中瓷电子科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<div><input type="checkbox"/>特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/> 分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/> 媒体采访</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/> 新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/> 路演活动</div> <div><input type="checkbox"/> 现场参观</div> <div><input type="checkbox"/> 其他 （请文字说明其他活动内容）</div>
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2025 年 4 月 28 日 (周一) 下午 15:00~16:30
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长 卜爱民 2、常务副总经理（代总经理） 梁向阳 3、财务总监、副总经理、董事会秘书 董惠 4、中信证券投行委工业与先进制造行业组副总裁 肖尧 5、中航证券有限公司证券承销与保荐分公司业务董事 闫亚格
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、一季度报告中当期净利润同比增长 39.87%，归母净利润同比增长 48.81%，两者增长率的差异是什么原因？</p> <p>您好，存在差异的原因主要为：1、2024 年 7 月收购国联万众剩余股权后对国联万众 100%控股，归母比例由 94.6029%上升为 100%；2、少数股东损益同比下降。感谢您的关心。</p> <p>2、一季度报告中扣除非经常性损益的净利润同比增长 68.76%，什么因素产生的增长？</p> <p>您好，扣非增长主要系受公司产品结构优化及成本管控增强，公司毛利水平有所增加。感谢您的关心。</p>

	<p>3、公司直销模式在 2024 年实现了 36.41 的增长，未来有哪些策略来维持或提升这一增长？</p> <p>公司直销模式的毛利率为 36.41%，具体详见公司年度报告，感谢您的关心。</p> <p>4、公司提到碳化硅主驱产品在比亚迪等车企验证中，目前验证阶段遇到哪些技术或供应链挑战？预计 2025 年量产时，配套芯片的良率目标是多少？除新能源汽车外，碳化硅模块在光储逆变器、轨道交通等领域的应用进展如何？</p> <p>您好，目前国联万众碳化硅主驱产品暂未大规模量产。主驱芯片良率大于 80%。国联万众公司目前市场推广顺利，目前储能、充电桩、工业电源、消费电子等均有突破，已有批量产品获得应用，轨道交通暂无客户导入，感谢您的关心。</p> <p>5、公司直销模式在 2024 年实现了 36.41%的增长，请问这种增长是否可持续？未来有哪些策略来维持或提升这一增长？</p> <p>公司直销模式的毛利率为 36.41%，具体详见公司年度报告，感谢您的关心。</p> <p>6、公司 25 年一季度报告中合并口径营业收入同比增长 12.01%，什么因素产生的增长？</p> <p>您好，公司 25 年一季度营收增长主要系市场开拓情况良好，电子陶瓷业务及碳化硅功率模块及其应用业务的营业收入增长较快；感谢您的关心。</p> <p>7、内部抵消数在 2024 年有所增加，这对公司整体财务状况有何具体影响？公司如何管理这一部分？</p> <p>2024 年内部抵消 5.01 亿元，2023 年内部抵消 6.25 亿元，2024 年内部抵消较 2023 年呈下降趋势，具体详见公司年度报告。公司按照相关法律法规及规范性文件对关联交易严格进行管理，感谢您的关心。</p> <p>8、博威公司（氮化镓射频芯片）和国联万众（碳化硅模块）的产能利用率如何？在 5G-A 基站、低空经济等新兴场景下，是否计划扩产？</p>
--	---

	<p>氮化镓射频芯片与碳化硅模块的产能分配是否可能因下游需求变化调整</p> <p>您好，公司及子公司目前订单饱满，产能利用率维持在较高的水平。博威公司氮化镓通信基站射频芯片及器件、微波点对点通信射频芯片与器件的设计、封装、测试和销售，产品主要用于5G、5G-A 通信基站及点对点通信的信号发射与接收。博威公司正积极推进低空经济等新型应用场景新产品开发，依托技术和产品优势，形成一定市场规模。同时，积极推进“氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目”、“通信功放与微波集成电路研发中心建设项目”、“第三代半导体工艺及封测平台建设项目”、“碳化硅高压功率模块关键技术研发项目”的建设。公司及子公司将时刻关注行业发展及市场需求情况，坚持以用户需求为导向、以技术创新为牵引，不断实现持续快速、高质量发展。感谢您的关心！</p> <p>9、看年度报告母公司现金流量表中经营活动产生的现金流量净额下降较多，主要是购买商品、接收劳务支付增长较多，请问支付金额较大的具体是什么原因？</p> <p>您好，主要系票据集中到期解付，使得购买商品、接收劳务支付的现金较上年同期增长较多，感谢您的关心。</p> <p>10、贵司 25 年一季度报告中归母净利润同比增长 48.81%，同比大幅增长的主要原因是什么？</p> <p>您好，公司归母净利润增长的原因一方面受公司产品结构优化及成本管控增强，公司毛利水平有所增加；另一方面，公司于2024 年 7 月收购国联万众剩余股权后对国联万众 100%控股，归母比例由 94.6029%上升为 100%。感谢您的关心。</p> <p>11、氧化铝/氮化铝陶瓷加热盘已批量供应半导体设备，但静电卡盘仍处于验证阶段。国际厂商（如京瓷）同类产品良率超 95%，公司当前验证阶段的良率水平如何？未来如何提升成本竞争力？</p> <p>您好，中瓷电子已开发了精密陶瓷零部件用氧化铝、氮化铝</p>
--	--

	<p>核心材料和配套的金属化体系，建立了完善的精密陶瓷零部件制造工艺平台，开发的陶瓷加热盘产品核心技术指标已达到国际同类产品水平并通过用户验证，实现了关键零部件的国产化，已批量应用于国产半导体关键设备中。目前精密陶瓷零部件领域新产品研发进度符合预期。感谢您的关心。</p> <p>12、请问何时收购大股东资产</p> <p>您好，公司暂无收购大股东其他资产计划，请关注公司指定信息披露平台公司公告，感谢您的关心。</p> <p>13、贵公司年报中，母公司利润表中营业收入同比增长 1.23%，但是期末应收账款较期初同比增长 45.07%，差异较大的原因是什么？</p> <p>您好，存在差异的主要原因系年末收取客户汇票的时间差异，及母公司应收子公司的应收账款期有所延长。感谢您的关心。</p> <p>14、公司 2024 年净敞口套期收益为-608,529.85 元。请问公司在套期保值策略上有何调整计划？如何进一步优化风险管理以应对市场波动？</p> <p>你好，公司 2024 年度净敞口套期收益为零；-608,529.85 元为汇兑损益的金额，主要系汇率变动影响所致，公司已及时监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。谢谢！</p> <p>15、2023 年重组后，氮化镓/碳化硅业务与原有电子陶瓷业务如何协同？研发资源是否共享？例如，精密陶瓷零部件技术是否反哺第三代半导体封装？</p> <p>您好，感谢您对公司的关注。公司内部已根据业务有序进行了板块重组、整合，在上市公司整体经营目标和战略规划下，在业务、资源、资产、财务、人员和机构等方面对标的资产进行整合管控，促进业务有效融合，优化资源配置，提高经营效率和效益，提升上市公司整体盈利能力。感谢您的关心。</p> <p>16、请问年报母公司利润表中信用减值损失增长的原因是什么？</p> <p>您好，年报母公司利润表中信用减值损失增长的原因主要系</p>
--	--

	<p>客户账期有所延长，导致应收账款增加及对应的坏账准备增加。感谢您的关心。</p> <p>17、董事长卜爱民募投项目“年产 44.05 亿只消费电子陶瓷产品产线”已于 2024 年投产，目前产能爬坡进度如何？是否带动消费电子业务营收占比提升至目标 20%以上？</p> <p>您好，中瓷电子 IPO 募投项目“消费电子陶瓷产品生产线建设项目”已经如期建成投产，正在陆续释放产能，目前产能正在爬坡中，已达到预定目标，详见公司年报。感谢您的关心。</p> <p>18、@董事长卜爱民公司提到“创建世界一流专业领军企业”目标，是否计划通过并购补全第三代半导体产业链（如芯片设计、设备材料）？潜在标的领域有哪些？</p> <p>您好，公司一直重视领域发展及市值管理工作，若有相关计划公司将按相关规定及时进行公告。感谢您的关心。</p> <p>19、在电子陶瓷外壳领域，公司对标京瓷的关键差距是什么？在材料配方（如高导热氮化铝）和工艺稳定性（如多层共烧技术）上是否有突破计划？</p> <p>您好，公司在电子陶瓷业务的技术优势主要体现在电子陶瓷新材料、半导体外壳仿真设计、生产工艺等方面。</p> <p>在材料方面，公司掌握多种陶瓷体系的知识产权，包括系列氧化铝陶瓷和系列化氮化铝陶瓷以及与其相匹配的金属化体系。</p> <p>在设计方面，公司拥有先进的设计手段和设计软件平台，可以对陶瓷外壳进行结构、布线、电、热、可靠性等进行优化设计。公司已经可以设计开发 1.6Tbps 光通信器件外壳和基板，与国外同类产品技术水平相当；具备氧化铝、氮化铝等陶瓷材料与新型金属封接的热力学可靠性仿真能力，满足新一代无线功率器件外壳散热和可靠性需求。</p> <p>在工艺技术方面，公司具有全套的多层陶瓷外壳制造技术，包括原材料制备、流延、冲孔冲腔、金属化印刷、层压、热切、烧结、镀镍、钎焊、镀金等技术。公司建立了完善的氧化铝陶瓷</p>
--	--

	<p>和氮化铝陶瓷加工工艺平台，建立了以流延成型为主的氧化铝多层陶瓷工艺，以厚膜印刷为主的高温厚膜金属化工艺，以高温焊料为主的钎焊组装工艺，以电镀、化学镀为主的镀镍、镀金工艺，建立了完善的精密陶瓷零部件制造工艺平台。感谢您的关心。</p> <p>20、年度报告利润表中合并口径营业收入有所下降的原因？</p> <p>您好，合并口径营业收入下降的原因，主要是受移动通讯市场需求波动的影响，氮化镓通信基站射频芯片与器件板块收入有所下降。感谢您的关心。</p> <p>21、领导，您好！我来自四川大决策请问，作为电子陶瓷材料龙头，公司在 5G 基站用高频介质陶瓷、功率半导体用氧化铝 / 氮化铝基板的技术参数是否已达到国际一流水平？与中芯国际、华为等核心客户的合作是否进入批量供货阶段？</p> <p>您好！感谢您的关注！公司电子陶瓷系列产品包括光通信器件外壳、无线功率器件外壳、红外探测器外壳、声表晶振类外壳、3D 光传感器模块外壳、氮化铝陶瓷基板、集成式加热器、精密陶瓷零部件等，广泛应用于光通信、无线通信、轨道交通、工业激光、消费电子、低碳供热制冷、汽车电子、半导体设备等领域。公司开创了我国光通信器件陶瓷外壳产品领域，持续创新材料和精益技术，已成为国内规模最大的高端电子陶瓷外壳产品制造商。感谢您的关心。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2025-04-28